

## 台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號  
4樓之11

承辦人：吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：屏東縣立中正國民中學

發文日期：中華民國113年7月11日

發文字號：台發協字第1130007005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：韓國首爾國際發明展簡章 (0007005A00\_ATTCH3.pdf、0007005A00\_ATTCH4.doc、  
0007005A00\_ATTCH5.doc)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2024SIIF韓國首爾國際發明展」。

說明：

一、台灣發明協會 Taiwan Invention Association，深耕國際發明圈52載，為世界各大著名發明展籌組台灣代表團參展，台灣代表團所展出之成績斐然，獲獎甚多，拓展之商機無限。

二、2024 SIIF韓國首爾國際發明展，是經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一，為亞洲最大發明展，敬邀貴校師生參與國際發明競賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。

三、參展日期、地點：113年11月27日~11月30日，韓國首爾世貿  
COEX展覽館展出，共為期4天

四、即日起報名至113年9月30日止，洽詢專線02-6605-7626吳秘書或email：tia7626@yahoo.com.tw或LINE ID:@123atruj

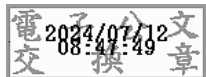
五、早鳥報名補助「香港創新發明展」參展費。

正本：屏東縣立明正國民中學、屏東縣立中正國民中學、屏東縣立鶴聲國民中學、屏東縣立至正國民中學、屏東縣立公正國民中學、屏東縣立潮州國民中學、屏東縣立光春國民中學、屏東縣立東新國民中學、屏東縣立內埔國民中學、屏東縣立崇文國民中學、屏東縣立萬丹國民中學、屏東縣立萬新國民中學、屏東縣立新園國民中學、屏東縣立長治國民中學、屏東縣立鹽埔國民中學、屏東縣立高樹國民中



學、屏東縣立高泰國民中學、屏東縣立里港國民中學、屏東縣立九如國民中學、  
屏東縣立萬巒國民中學、屏東縣立佳冬國民中學、屏東縣立林邊國民中學、屏東  
縣立竹田國民中學、屏東縣立琉球國民中學、屏東縣立南州國民中學、屏東縣立  
麟洛國民中學、屏東縣立新埤國民中學、屏東縣立車城國民中學、屏東縣立滿州  
國民中學、屏東縣立瑪家國民中學、屏東縣立泰武國民中學、屏東縣立牡丹國民  
中學、屏東縣立獅子國民中學、屏東縣立恆春國民中學、屏東縣私立南榮國民中  
學、中華台北著作權人協會

副本：



張家菊 會長

裝

訂



線



# 2024 第 20 屆韓國首爾國際發明展 台灣參展團



## Seoul International Invention Fair 2024

### 邀 請 函

發明先進：敬啟

發明界的新興市場，第廿屆韓國首爾國際發明展即將開鑼，本會繼上屆優良成果，繼續組團參加。

韓國市場為台灣的二倍，上屆有來自 19 個國家，近 500 件作品參展，是一個地理相近又可相互砥礪吸取經驗的展覽，千萬不要錯失這一年一度的盛會，本會與全體工作人員誠摯的邀請，同時亦期望您的作品可在一夕間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明人的新作品，以予學習改進參考。

今年我們除了傳承以往的優點外，特別報告如下：

您的作品若擁有台灣專利(展前四年內取得)參展獲金、銀、銅牌之獎項，可得經濟部智慧財產局之機票部份補助。(詳見內頁獎助辦法說明)

**展出日期：2024 年 11 月 27 日-11 月 30 日**

**即日起接受報名至 9 月 30 日截止**



台灣發明協會

團長 **張家菊** 敬邀

# 2024 韓國首爾第 20 屆國際發明展-參展辦法

- 一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力，促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價值，特定本參展辦法。
- 二、主辦單位：Korea Invention Promotion Association (KIPA)
- 三、台灣授權單位：台灣發明協會
- 四、團名：2024 韓國首爾國際發明展-台灣參展團
- 五、依據：韓國首爾國際發明展覽大會授權書
- 六、展出日期：2024 年 11 月 27 日至 11 月 30 日
- 七、展出地點：韓國首爾世貿展覽館 Exhibition Hall C, COEX  
COEX, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul 06164, Korea
- 八、參展作品：凡有前往參展之作品有台灣專利證書者(展前四年內取得)，一但得獎，經濟部智慧財產局將補助部份機票費，以茲鼓勵。  
註：若無台灣專利證書也可參展但無補助。
- 九、參展費用：

1. 國內報名費 **新台幣 5,000 元** (限同參展人或同單位)

2. 攤位費：

攤位面積  $3^m \times 3^m \times 2.4^m$ ，每攤 **新台幣 51,000 元**

(一個攤位可展三件作品，限同參展人或同單位)

3. 專刊、海報費用 **新台幣 4,000 元/件**。(統一製作)

4. 其他費用：

①隨團個人旅費：**新台幣 42,800 元** (不含機票)

(請自行轉付旅行社) (刷卡需另+2%手續費)

(國際機票浮動大，建議提早自行訂購或洽本會配合之旅行社訂購。)

②參展品運送費用另計。(詳洽 裕航空運 翁小姐 02-2777-1620#28)

③展覽會場之另加租桌椅...等其他費用另計。

十、即日起接受報名至 9 月 30 日截止

※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法於韓國展覽大會專刊裡刊登。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先選位)

※ 素食者或需住單人房(另加台幣 16,000 元)也請於隨團報名表裡註明。

※ 每攤位含一桌一椅(展桌尺寸：長 100 寬 50 高 75 公分)。

電源插座(220V, 60Hz, 1kw)。



## 繳交參展資料明細單：

以下資料請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入 xxx(個人名、學校名或公司名)報名韓展。

文字部份請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔交件，繳交其他檔案格式歉難受理作業，每件作品請獨自建立一資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便通知補件作業，謝謝。

- 1. 已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)
- 2. 切結書(請由一位發明人代表簽名或蓋章)
- 3. 參展品台灣專利證書掃描檔案(或專利申請中收據)  
(無專利者免附。有專利卻未檢附者，歉難申請經濟部機票補助)
- 4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)
- 5. 隨本團前往參展人員請附上隨團報名表(含護照影本)
- 6. 自行前往參展人請提供個人中英文姓名，以便申請參展識別證。
- 7. 發明人或聯絡人名片一張

報名日期：即日起接受報名至 9月30日截止

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

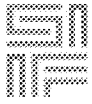


台灣發明協會  
官方好友 LINE

- 以上資料請於報名截止日前，連同訂金 **20,000元/攤位**，繳交至本會，以順利完成報名手續。
- 電匯資料：新光銀行(銀行代碼103) 北三重分行

戶名：**台灣發明協會**

帳號：**0310-10-100304-3**



# 2024 韓國首爾國際發明展參展報名表

發明人姓名  請勿修改表格  請勿修改表格  請勿修改表格	發明人填寫姓名注意事項：發明人姓名為若得獎獎狀上的得獎名稱，一位以上之發明人，請一律填寫於欄位內，資料一旦送出，不得變更更改。(含若得獎的得獎證書)		
	(中+英) 範例：王小明 Wang Hsiao-Ming		
公司/學校名稱	(中)	統一編號	
	(英)		
聯絡地址	(中) □□□-□□		
	(英)		
電話		手機	
E-mail			
http://			
聯絡人	姓名：	職稱：	參展品類別 請參閱下頁選項 填入一類別編號
	電話：		
	E-mail:		
台灣專利	<input type="checkbox"/> 發明_____號 <input type="checkbox"/> 新型_____號 <input type="checkbox"/> 設計_____號		
專利名稱	<input type="checkbox"/> 公告中案號_____號		
	<input type="checkbox"/> 申請中案號_____號		
作品名稱	(中文)		
	(英文)		
作品介紹	產品介紹(中英文簡要說明各約 100 字) (作品照片請另檢附 JPG 檔，勿貼在此報名表內。)		

(以上所有欄位請確實詳細填寫後再次確認檢查，報名表送出後不得變更及修改內容。)

## CLASS - CHECK THE CATEGORY OF YOUR INVENTION (產品種類)

<b>A</b>	Mechanics(機械學) / Engines(引擎) / Machinery(機械) / Tools(工具) / Industrial process(工業生產流程) / Metallurgy(冶金學)
<b>B</b>	Computer science(電腦科學) / Software(軟體) / Electronics(電子) / Electricity Methods of Communication(電力通信方法)
<b>C</b>	Building(建築) / Architecture(建築學) / Civil Engineering(土木工程) / Construction(建造) / Materials(材料) / Woodwork(木工)
<b>D</b>	Sanitation(公共、環境衛生) / Ventilation(通風設施) / Heating(暖氣)
<b>E</b>	Security(安全) / Rescue(救援) / Alarm(警報裝置)
<b>F</b>	House-keeping and nutrition(家務管理及營養學)
<b>G</b>	Commercial, Industrial, and Office equipment(商業、工業以及辦公室的設備)
<b>H</b>	Agriculture(農業) / Forestry and Garden(林業及園藝) / Pet and Farm animal supplies(寵物及家畜相關產品)
<b>I</b>	Traffic(交通) / Transport(運輸) / Car accessories(汽車用品)
<b>J</b>	Medical Technology(醫學科技) / Medicine(藥品) / Hygiene(衛生) / Cosmetics(美容、化妝品)
<b>K</b>	Graphic arts(平面藝術) / Advertising(廣告)
<b>L</b>	Teaching research and pedagogical items(教學研究及教學項目)
<b>M</b>	Games(遊戲) / Sport(運動) / Hobby(嗜好)
<b>N</b>	Information technology(資訊科技)
<b>O</b>	Environmental protection(環境保護)
<b>P</b>	Other inventions and new practical products(其他類發明品及新型實用產品)

# 切 結 書

※每件作品請一位發明人代表填寫一份切結書，請簽名或用印後掃描回傳。

本人參加 2024 韓國首爾國際發明展，其參展報名表填寫之所有內容，皆已再次確認無誤，同意報名表送出後，不得再做任何修改及變更，含若得獎的得獎證書亦同。

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國際裁判的評審結果，絕無異議。

## 立書人

姓 名： (簽/蓋章)

公司/學校：

身分證字號：

住 址：

電 話：

作品名稱：

中華民國 113 年 月 日